

где q_i — обобщённые координаты, Q_i — обобщённые силы. Для сил, действующих на тело, имеющее неподвижную ось вращения z , $dA = M_z d\varphi$, где M_z — сумма моментов сил относительно оси вращения, φ — угол поворота тела. Для сил давления $dA = pdV$, где p — давление, V — объём.

Р. в. на конечном перемещении определяется как предел интегральной суммы соответствующих элементарных работ и при перемещении M_0M_1 выражается криволинейным интегралом

$$A = \int_{M_0M_1} (F_x \cos \alpha) ds \text{ или } A = \int_{M_0M_1} (F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$

Для потенциальных сил $dA = dU$ или $dA = -d\Pi$, где U — силовая ф-ция, Π — потенциальная энергия системы, $A = U_1 - U_0$ или $A = \Pi_0 - \Pi_1$, где U_0, U_1, Π_0, Π_1 — значения соответствующих величин в начальном и конечном положениях системы; в этом случае Р. в. не зависит от вида траекторий точек приложения сил. При движении механич. системы сумма работ всех действующих сил на нек-ром перемещении этой системы равна изменению её кинетической энергии T на этом же перемещении, т. е.

$$\sum A_i = T_1 - T_0.$$

Понятие Р. в. широко используется в механике и в др. областях физики, а также в технике. С. М. Тарг. РАБОТА ВЫХОДА — энергия, к-рая затрачивается твёрдым или жидким телом при тепловом возбуждении электрона этого тела в вакуум (в состояние с равной и улю кинетич. энергией). Р. в. равна разности двух энергий: 1) энергии покоящегося электрона, находящегося в такой точке вне тела, к-рая, с одной стороны, удалена от поверхности тела на расстояние, во много раз превышающее межатомные расстояния, а с др. стороны, гораздо ближе к рассматриваемой поверхности тела, чем к др. телам и к краю этой поверхности (в частности, эта точка должна быть далека от края рассматриваемой кристаллич. грани); 2) эл.-хим. потенциала электронов в рассматриваемом теле, к-рый в состоянии термодинамич. равновесия одинаков во всех точках тела. Если эл.-статич. потенциал в вакууме в указанной точке равен $\Phi_{\text{вак}}$, в объёме тела — $\Phi_{\text{об}}$, ϵ_F — ферми-энергия электронов (уровень их хим. потенциала), $\epsilon_F - \epsilon_{\text{об}}$ — эл.-хим. потенциал электронов в рассматриваемом теле, то Р. в. равна

$$\Phi = -e\Phi_{\text{вак}} - (\epsilon_F - e\Phi_{\text{об}}). \quad (1)$$

Основная часть Р. в. представляет собой энергию связи электрона в твёрдом теле с атомными ядрами и др. электронами и аналогична энергии ионизации атомов и молекул. Однако есть ещё вклад в Р. в., связанный с наличием в приповерхностной области любого тела двойного электрич. слоя. Он возникает даже на идеально правильной и чистой поверхности кристалла в результате того, что «центр тяжести» плотности электронов в приповерхностной кристаллич. ячейке не совпадает с плоскостью, в к-рой расположены ионы. При этом разность $\Phi_{\text{вак}} - \Phi_{\text{об}} = 4\pi P_s$, где P_s — дипольный момент двойного слоя, приходящийся на единицу площади поверхности ($P_s > 0$, если дипольный момент направлен наружу). Толщина двойного слоя в металлах и аналогичного двойного слоя в полупроводниках порядка межатомных расстояний. В полупроводниках вблизи поверхности помимо этого возникает ещё двойной слой в виде области пространственного заряда, толщина к-рой может достигать тысяч межатомных расстояний.

Р. в. — характеристика поверхности тела. Границы одного и того же кристалла, образованные разными кристаллографич. плоскостями или покрытые разными

веществами, имеют разные величины P_s и потому разные Р. в. Потенциалы Фавак этих поверхностей разные (каждый из этих потенциалов определяется в точке, близкой к соответствующей поверхности), поэтому между поверхностями возникают контактная разность потенциалов и соответствующее эл.-статич. поле.

Р. в. может быть сильно изменена адсорбцией разл. атомов или молекул на поверхности (адсорбированные частицы изменяют величину P_s) даже в том случае, когда объёмные свойства тела неизменны. Атомы металлов с малой энергией ионизации, напр. Cs, снижают Р. в. — в нек-рых полупроводниках до величины ~ 1 эВ (см., напр., табл.).

Если на поверхности полупроводника нет поверхности состояний [напр., поверхности (110) GaAs и InP], то при изменении уровня Ферми ϵ_F в объёме (при легировании полупроводника или изменении температуры) изменяется и Р. в. — в соответствии с формулой (1). Однако при большой плотности поверхностных состояний (как, напр., у Ge, Si) изменение ϵ_F вызывает такое изменение $\Phi_{\text{вак}}$ — Фоб, к-рое компенсирует изменение ϵ_F , так что Р. в. оказывается нечувствительной к изменениям ϵ_F в объёме полупроводника.

Р. в. определяет величину и температурную зависимость тока термоэлектронной эмиссии. В зависимости от того, в каких условиях происходит эмиссия электронов — адиабатических или изотермических, с Р. в. совпадает изменение внутр. энергии или соответственно свободной энергии тела, связанное с испусканием одного электрона.

Мин. энергия, требуемая для эмиссии электрона при фотоэлектрич. эффекте, при вторичной электронной эмиссии, когда эмиссия происходит не в результате спонтанного теплового возбуждения за счёт внутр. энергии тела, а под действием внеш. источника (света, быстрого электрона), в общем случае отличается от Р. в., к-рую поэтому для определённости называют термоэлектронной Р. в. В металлах и сильно легированных (вырожденных) полупроводниках, в к-рых верх. уровень заполненных электронами состояний совпадает с ϵ_F , фотоэлектрич. Р. в. совпадает с термоэлектронной Р. в. Но в сравнительно чистых полупроводниках верхний заполненный уровень совпадает с краем валентной зоны, к-рый во мн. случаях ниже ϵ_F , вследствие чего фотоэлектрич. Р. в. больше термоэлектронной Р. в.

Р. в. измеряют по температурной зависимости и по величине термоэмиссионного тока; в металлах и вырожденных полупроводниках — по красной границе внешн. фотоэффекта. Контактная разность потенциалов U_k двух тел равна разности их Р. в.; измеряя U_k между исследуемой поверхностью и эталонной, Р. в. к-рой известна, находят Р. в. первой.

Работа выхода (в эВ) некоторых поликристаллических металлов, полупроводников и отдельных граней монокристалла вольфрама

Li	2,38	Fe	4,31	Cu	4,40	Ge	4,76	Ni(Cs)
K	2,22	Cr	4,58	Ag	4,3	Si	4,8	W (110) 1,37
Gs	1,81	Co	4,41	Au	4,30	Ag ₂ O(Cs)	5,3	W (111) 0,75
Ni	4,50	Mn	3,83	W	4,54	Ta(Cs) 1,1	4,4	W (100) 4,6

Примечание. (Cs) обозначает покрытие цезием.

Лит.: Фоменко В. С., Эмиссионные свойства материалов, Справочник, 4 изд., К., 1981; Добрецов Л. Н., Гомюнова М. В., Эмиссионная электроника, М., 1966; Ривье Х., Работа выхода. Измерения и результаты, в сб.: Поверхностные свойства твёрдых тел, под ред. М. Грина, пер. с англ., М., 1972. Ш. М. Коган.

РАВНОВЕСИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ — состояние, при к-ром все точки механич. системы находятся в покое по отношению к рассматриваемой системе отсчёта. Если система отсчёта является инерциальной,